

(以下附錄節錄自中華人民共和國國家稅務總局的網站，全文可參閱
<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5163819/content.html>)

附錄

中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告 2021 年第 9 号

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8 号，以下简称《若干政策》)及其配套税收政策有关要求，现将《若干政策》第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告如下：

一、《若干政策》所称国家鼓励的集成电路设计企业，必须同时满足以下条件：

(一) 在中国境内(不包括港、澳、台地区)依法设立，从事集成电路设计、电子设计自动化(EDA)工具开发或知识产权(IP)核设计并具有独立法人资格的企业；

(二) 汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的月平均职工人数不少于 20 人，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 50%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 40%；

(三) 汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和，下同)总额的比例不低于 6%；

(四) 汇算清缴年度集成电路设计(含 EDA 工具、IP 和设计服务，下同)销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于 60%，其中自主设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于 50%，且企业收入总额不低于(含)1500 万元；

(五) 拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权，企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权合计不少于 8 个；

(六) 具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境和经营场所，且必须使用正版的 EDA 等软硬件工具；

(七) 汇算清缴年度未发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

二、《若干政策》所称国家鼓励的集成电路装备企业，必须同时满足以下条件：

(一) 在中国境内(不包括港、澳、台地区)依法设立，从事集成电路专用装备或关键零部件研发、制造并具有独立法人资格的企业；

(二) 汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有大学专科及以上学历月平均职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于 40%，研究开发人员月平均数占企业当年月平均职工总数的比例不低于 20%；

(三) 汇算清缴年度用于集成电路装备或关键零部件研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于 5%；

(四) 汇算清缴年度集成电路装备或关键零部件销售收入占企业销售(营业)收入总额的比例不低于 30%，且企业销售(营业)收入总额不低于(含)1500 万元；

(五) 拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权，企业拥有与集成电路装备或关键零部件研发、制造相关的已授权发明专利数量不少于 5 个；

(六) 具有与集成电路装备或关键零部件生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件；

(七) 汇算清缴年度未发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

三、《若干政策》所称国家鼓励的集成电路材料企业，必须同时满足以下条件：

(一) 在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法设立，从事集成电路专用材料研发、生产并具有独立法人资格的企业；

(二) 汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有大学专科及以上学历月平均职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于 40%，研究开发人员月平均数占企业当年月平均职工总数的比例不低于 15%；

(三) 汇算清缴年度用于集成电路材料研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 5%；

(四) 汇算清缴年度集成电路材料销售收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 30%，且企业销售（营业）收入总额不低于（含）1000 万元；

(五) 拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权，且企业拥有与集成电路材料研发、生产相关的已授权发明专利数量不少于 5 个；

(六) 具有与集成电路材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件；

(七) 汇算清缴年度未发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

四、《若干政策》所称国家鼓励的集成电路封装、测试企业，必须同时满足以下条件：

(一) 在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法设立，从事集成电路封装、测试并具有独立法人资格的企业；

(二) 汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有大学专科以上学历月平均职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于 40%，研究开发人员月平均数占企业当年月平均职工总数的比例不低于 15%；

(三) 汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 3%；

(四) 汇算清缴年度集成电路封装、测试销售（营收）收入占企业收入总额的比例不低于 60%，且企业收入总额不低于（含）2000 万元；

(五) 拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权，且企业拥有与集成电路封装、测试相关的已授权发明专利、计算机软件著作权合计不少于 5 个；

(六) 具有与集成电路芯片封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件；

(七) 汇算清缴年度未发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

五、本公告企业条件中所称研究开发费用政策口径，按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 40 号）

等规定执行。

六、符合条件的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，按照《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）规定的“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式享受税收优惠，主要留存备查资料见附件。享受优惠的企业在完成年度汇算清缴后，按要求将主要留存备查资料提交税务机关，由税务机关按照财税〔2016〕49 号第十条规定转请省级工业和信息化主管部门进行核查。

七、本公告自 2020 年 1 月 1 日起实施，由工业和信息化部会同国家发展改革委、财政部、税务总局负责解释。

附件：享受企业所得税优惠政策的国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业主要留存备查资料

工业和信息化部
国家发展改革委
财政部
国家税务总局
2021 年 4 月 22 日

附件

享受企业所得税优惠政策的国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业 主要留存备查资料

企业类型	资料清单（复印件须加盖企业公章）
集成电路设计企业	<ol style="list-style-type: none">1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料；3.企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/领域/对应销售（营业）收入规模）；4.企业拥有与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权登记证书的材料；5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；6.第三方检测机构提供的集成电路主要产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；7.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的材料。
集成电路装备企业	<ol style="list-style-type: none">1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料；3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）；4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利材料；5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路装备销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；

企业类型	资料清单（复印件须加盖企业公章）
	<p>6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</p> <p>7.企业具有与集成电路装备生产相适应的经营场所、软硬件设施等材料。</p>
集成电路材料企业	<p>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；</p> <p>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料；</p> <p>3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）；</p> <p>4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利材料；</p> <p>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路材料销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；</p> <p>6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</p> <p>7.企业具有与集成电路材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等材料。</p>
集成电路封装、测试企业	<p>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；</p> <p>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料；</p> <p>3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）；</p> <p>4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利、计算机软件著作权登记证书的材料；</p> <p>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路封装、测试销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；</p> <p>6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</p> <p>7.企业具有与集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等材料。</p>